

特点

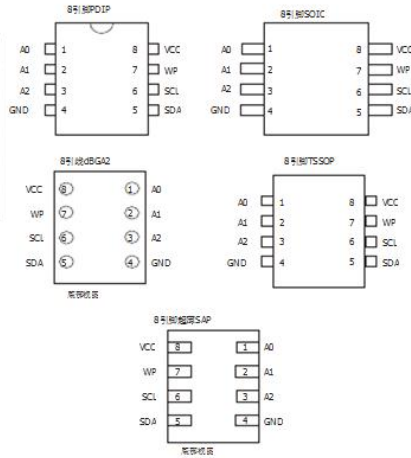
- 低电压和标准电压工作
 - 1.8 (V_{CC} = 1.8V至5.5V)
- 内部组织为32,768 × 8
- 两线串行接口
- 施密特触发器滤波输入抑制噪声
- 双向数据传输协议
- 1兆赫 (5.0V, 2.7V, 2.5V) 和400 kHz (1.8V) 的兼容性
- 写保护引脚用于硬件和软件数据保护
- 64字节页写模式 (部分页写允许)
- 自定时写周期 (5ms以下)
- 高可靠性
 - 耐力: 一百万次擦写循环
 - 数据保存: 40年
- 提供无铅/无卤设备
- 8引脚PDIP JEDEC, 8引脚SOIC封装JEDEC, EIAJ SOIC, 8引脚超薄小阵列包 (SAP), 8引脚TSSOP和8球dBG2包
- 模具销售: 晶圆形式, 松饼包撞到晶圆

描述

该AT24C256B提供262,144位的串行电可擦除可编程只读组织为每8位32768字存储器 (EEPROM)。该设备的级联功能允许多达八个器件共用一个两线总线。所述装置被用于很多工业和商业应用中优化的其中, 低功耗和低电压操作是必不可少的。该器件可采用节省空间的8引脚PDIP JEDEC, 8引脚SOIC JEDEC, 8引脚超薄SAP, 8-引脚TSSOP和8球dBG2包。另外, 全家人都在用一个1.8V (1.8V至5.5V) 版本。

引脚网络gurations

引脚名称	功能
A0-A2	地址输入
SDA	串行数据
SCL	串行时钟输入
WP	写保护
GND	地



两线串行

EEPROM

256K (32,768 × 8)

AT24C256B

软件5279C - SEER - 3/05



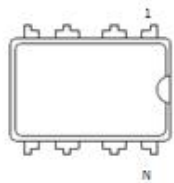
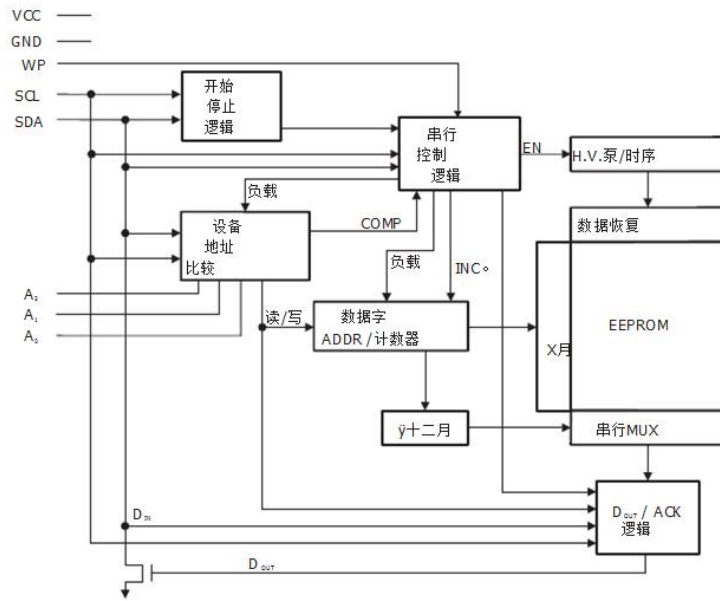
1. 绝对最大额定值*

工作温度	- 55 °C至+ 125°C
储存温度	- 65 °C至+ 150°C
任何引脚电压 相对于地面	- 1.0V至+ 7.0V
最大工作电压6.25V
直流输出电流 5.0毫安

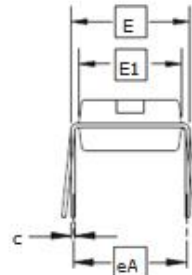
*注意:

强调超越“绝对上市最大额定值”, 可能会造成永久性损坏年龄到设备。这是一个压力只有额定值。该器件在这些或任何功能操作超出所指示的其他条件本规范的业务部门所不暗示。暴露在绝对最大额定值长时间条件可能会影响器件的可靠性。

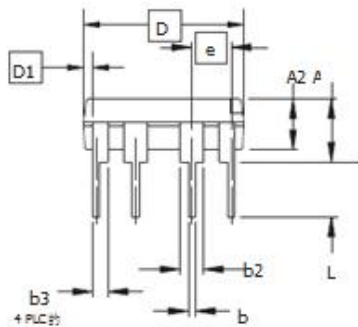
图1-1。 框图



顶视图



端视图



SIDE VIEW

常见尺寸
(单位:英寸)

符号	低	嘴	最大	记
A	-	-	0.210	2
A2	0.115	0.130	0.195	
b	0.014	0.018	0.022	5
b2	0.045	0.060	0.070	6
b3	0.030	0.035	0.045	6
c	0.005	0.010	0.014	
D	0.355	0.365	0.400	3
D1	0.005	-	-	3
E	0.300	0.310	0.325	4
E1	0.240	0.250	0.280	3
e	0.100 BSC			
eA	0.300 BSC			4
L	0.115	0.130	0.150	2

- 注意事项: 1. 本图仅提供信息, 请参考JEDEC标准MS-001, BA变化, 以获取更多信息。
 2. 尺寸A和L的测量与JEDEC飞机座位计GS-37符合。
 3. D, D1和E1尺寸不包括引脚端部突起。引脚端部突起不得超过0.010英寸。
 4. E和EA的测量应在垂直于引脚的方向。
 5. 尖峰引脚的端部应磨圆, 以减少应力。
 6. B2和B3的最大尺寸不包括引脚突起。密封突起不得超过0.010 (0.25毫米)。

01/09/02



2325 2325 2325
 2325 2325 2325

标题

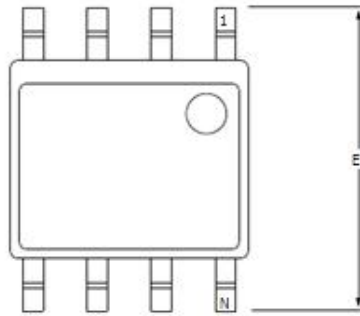
8P3, 8 引脚, 0.300" 宽体, 塑料双
 直插式封装 (PDIP)

图号

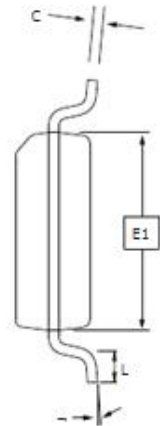
8P3

指示录

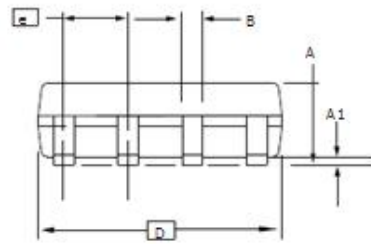
B



顶视图



侧视图



SIDE VIEW

常见尺寸
(计量单位:mm)

符号	值	范围	最大值	备注
A	1.35	-	1.75	
A1	0.32	-	0.25	
b	0.31	-	0.51	
C	0.17	-	0.25	
D	4.82	-	5.00	
E1	3.81	-	3.99	
E	5.75	-	6.20	
e	1.27 BSC			
L	0.45	-	1.27	
-	Ø	-	Ø	

注：该图仅供参考，不作为生产依据。请参考JEDEC标准中 012 定义封装尺寸。 © 德州仪器

10/7/03

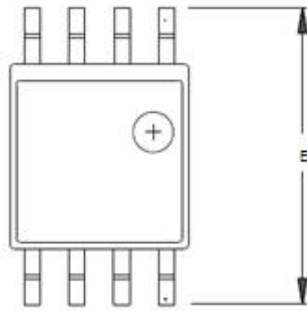


1150 E. 夏安MTN., 大境
科罗拉多斯普林斯, CO 80906

标题
881, 8引脚 (0.150" 宽度), 塑料封装
小外形 (JEDEC SOIC)

图号:
851

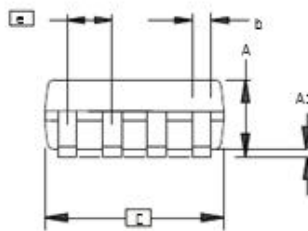
指示表
E



顶视图



端视图



SIDE VIEW

常见尺寸
(单位: mm)

符号	低	高	最大	注
A	1.70		2.16	
A1	0.08		0.25	
b	0.35		0.46	5
C	0.15		0.35	5
D	5.13		5.35	
E1	5.16		5.40	2, 3
E	7.70		8.26	
L	0.50		0.85	
?	0"		0"	
e	1.27 BSC			4

1. 此图仅供参考, 请参考EIAJ EDR-7520的更多规范。
2. 不包括在上, 下部和顶部毛刺的不平整。
3. 建议在上和下部相等, 如果它们是不同的, 较大尺寸应优先。
4. 确定其实际的几何位置。
5. 项目B, C适用于引线终端, 镀层的标准厚度应为0.007至0.021微米不等。

4/7/06

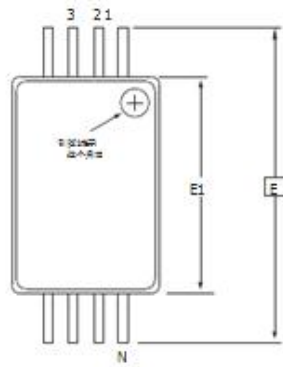


2325百汇街
桑何高, 加利福尼亚95131

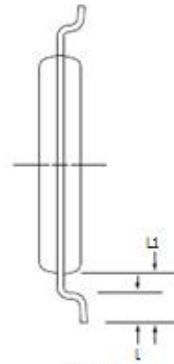
标题
8S2, 8引脚, 0.209"体, 规格小
外形封装 (EIAJ)

图号:
8S2

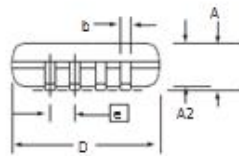
指示表
D



顶视图



端视图



SIDE VIEW

典型尺寸
(计算单位mm)

符号	说 明	最 大	值	
D	2.90	3.00	3.10	2.5
E	6.40 BSC			
E1	4.30	4.40	4.50	3.5
A	-	-	1.20	
A2	0.80	1.00	1.05	
b	0.15	-	0.30	4
e	0.65 BSC			
L	0.45	0.60	0.75	
L1	1.00参考			

- 注意事项: 1. 本图仅供参考, 请参考DEC MO 规格-153, 变化机管用的正确尺寸, 公差, 公差等。
 2. 尺寸D不包括引脚, 突出或引脚, 焊点或光刻, 突起和引脚引脚不得超过0.15毫米 (0.006英寸), 焊点。
 3. 尺寸E1不包括引脚用的引脚或突起, 引脚和突起不得超过0.25毫米 (0.010), 焊点。
 4. 尺寸b不包括dambar突出, 允许DAMBAR突出量计为0.08毫米焊点的B尺寸在最大的封装条件, 引脚不定位引脚的下部半路上, 本图的最小引脚突起和引脚的引脚为0.07毫米。
 5. 尺寸D和E, 公差于图H确定

5/30/02



2325百汇园
桑何路, 加利福尼亚95131

标题
8A2, 8引脚, 4.4 mm高度, 塑料
超薄封装小型封装 (TSSOP)

图号:

8A2

图示录

E